

中期経営計画  
**MIRAI 2026**  
あらたな価値の創造

2024年5月20日

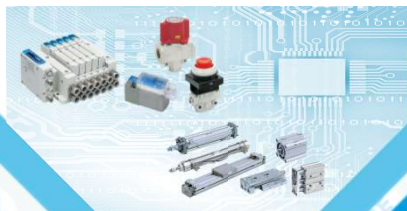
**内外テック株式会社**  
(証券コード：3374)



## 半導体関連企業を支えるリーディングカンパニー

半導体市場のすべてを支えます  
パーツ販売から設計・開発、組立、加工、メンテナンスサポートまで、長年の経験で培った技術で、  
最適なソリューションを提供

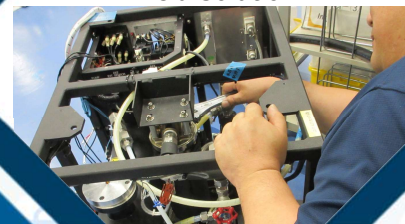
**SS事業**  
販売  
Supply Chain Solution



**MS事業**  
受託組立  
Manufacturing Solution



**FS事業**  
メンテナンスサポート  
Field Solution



**TS事業**  
製品開発・技術開発  
Technical Solution



**PS事業**  
精密加工  
Precision Machining Solution





## 最適化されたサプライチェーンとバリューチェーン

総合的なソリューション提供による半導体市場ニーズを最適サポート

## 高い信頼性と持続性

高品質なサービスにより、半導体製造工程の安定稼働をサポート





## 中期経営計画 MIRAI 2026目標

技術の進化とイノベーションで社会に貢献し  
ステークホルダーに認めて頂く会社を目指すと共に、  
社員が豊かで楽しく仕事ができる会社を目指します。

### 最先端の産業創出に貢献

- ・半導体市場における新しい技術や製品を開発し、  
これによる産業の進歩と発展を促進します
- ・半導体産業の雇用機会の提供により地域経済の発展に貢献します

### 快適な暮らしに貢献

- ・半導体技術は、デジタル化社会の基盤としてコミュニケーションや  
ビジネスプロセスの効率向上により、人々の豊かな生活に貢献します
- ・自動運転やスマートシティの構築により、  
安全・安心・快適な社会の提供と社会の課題解決に貢献します

### 温暖化、気候変動に貢献

- ・半導体技術は、エネルギー効率の向上による省エネルギーの  
家電製品や自動車の電動化に貢献します

### ウェルビーイングに貢献

半導体技術は、教育、健康、福祉のデジタル変革を推進し、  
より良い生活の質を実現することで、  
社会全体のウェルビーイングに貢献します

Purpose

あらたな  
価値の創造

半導体市場の技術革新・成長を通じ、  
人材育成と持続可能性に注力し、  
新たな価値・未来を創造します

Vision

技術の  
架け橋で  
未来をデザイン

技術と人を結びつけ、  
半導体・エレクトロニクス市場で  
革新的なソリューションとサービスを  
提供し、ステークホルダーと価値を  
共創します



NaigaiTEC

Mission

MIRAIを拓く  
5つのキーワード

- ① Market creation
- ② Innovation
- ③ Resilience
- ④ Alliance
- ⑤ Integration

# 中期経営計画 MIRAI 2026で目指す姿

目指す姿  
2030

## あらたな価値の創造

半導体市場の技術革新・成長を通じ、人材育成と持続可能性に注力し、新たな価値・未来を創造します

中計  
2026

## MIRAI 2026 ~2030年に向けた基盤の確立~

・MIRAI 重点戦略を通じて、持続可能で進化する未来の実現

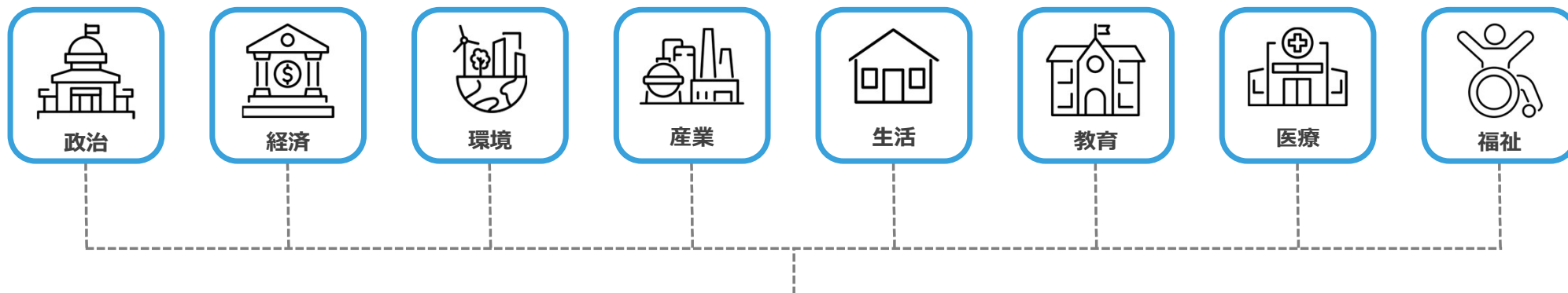
- Market creation : 新市場の創造
- Innovation : 技術革新
- Resilience : 変化への柔軟な対応
- Alliance : サプライチェーンの連携
- Integration : 価値の統合

中計  
2023

継続

半導体製造装置の高真空分野のNo.1プロバイダーになる

# パラダイムシフト



## AIによる革新的な変化

AIが半導体業界に変革をもたらし、より高度な技術が社会に変化をもたらす

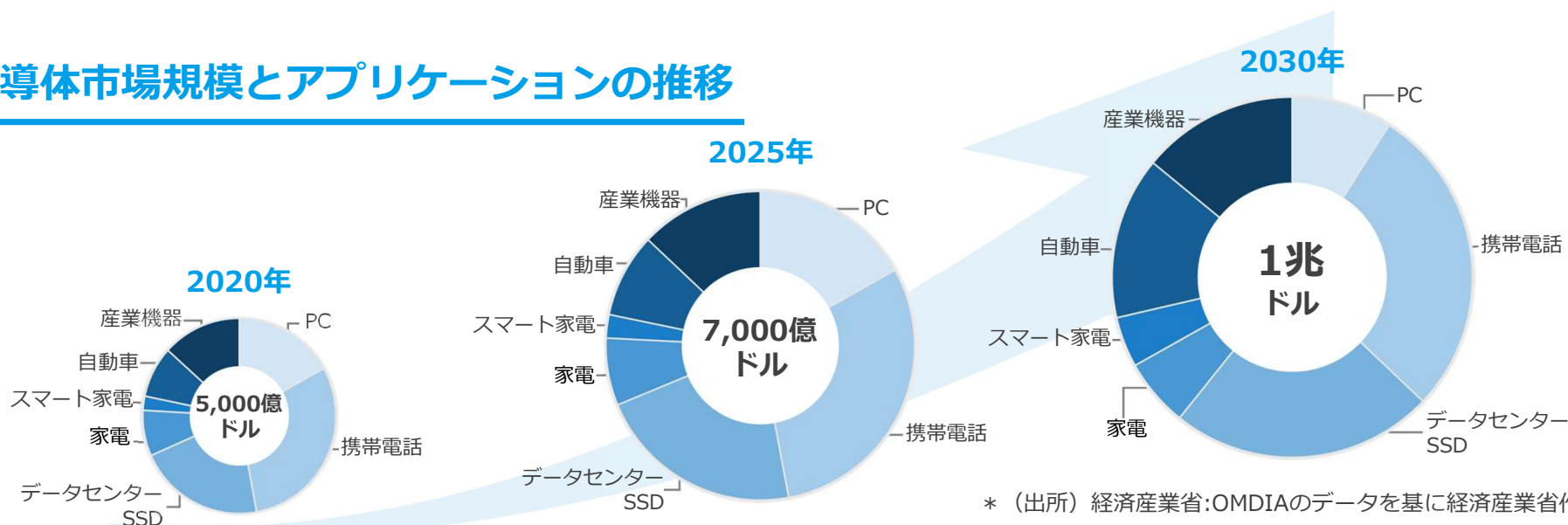
## 国家戦略の鍵となる半導体業界の大転換、日本の半導体市場回帰

量的変化 → 今までの需要に対し2倍

質的变化（技術的变化） → 高速化・微細化・省電力化

# 成長への大きなチャンス

## 半導体市場規模とアプリケーションの推移



### 半導体業界 (デバイス・メーカー)

- AI、メタバース、DX、GX、特にAIの需要が予想を大幅に超える
- 半導体市場の成長加速、更なる市場拡大

日本の半導体産業が復活



### 半導体製造装置業界

- 2023年度第4四半期から設備投資が再開し、3年以内に過去最高を更新する見込み
- 日本、中国、台湾、韓国、米国、欧州を含む世界各国で補助金により設備投資が拡大


主力事業に  
新たなチャンス

# 半導体市場を牽引するAI市場の成長

## 半導体製造装置分野へ寄与

### 生成AI

数千個のGPU(半導体チップ：画像処理プロセッサ)を使用するチャットGPTに代表される生成AI（人間の指示に基づき文章や画像を自動で生成する人工知能）を含むAI市場は、2032年には1.9兆ドル市場となる見込み

 <p><b>GPU</b></p> <p>数千個～数千個のコア</p>	 <p>頭脳にあたるコアの数が全然違う</p>	 <p><b>CPU</b></p> <p>数個～数十個のコア</p>
<p>トランジスタ数</p> <p><b>800</b>億個</p>	<p>演算性能</p> <p>1秒間に</p> <p><b>3958</b>兆回</p>	<p>回線幅</p> <p><b>4</b>ナノメートル</p>

400億ドル

1990年 2000年 2010年 2020年 2030年

2030年  
1兆ドル超  
半導体市場

市場が約**5倍**の  
**1.9兆**ドル  
**AI市場**

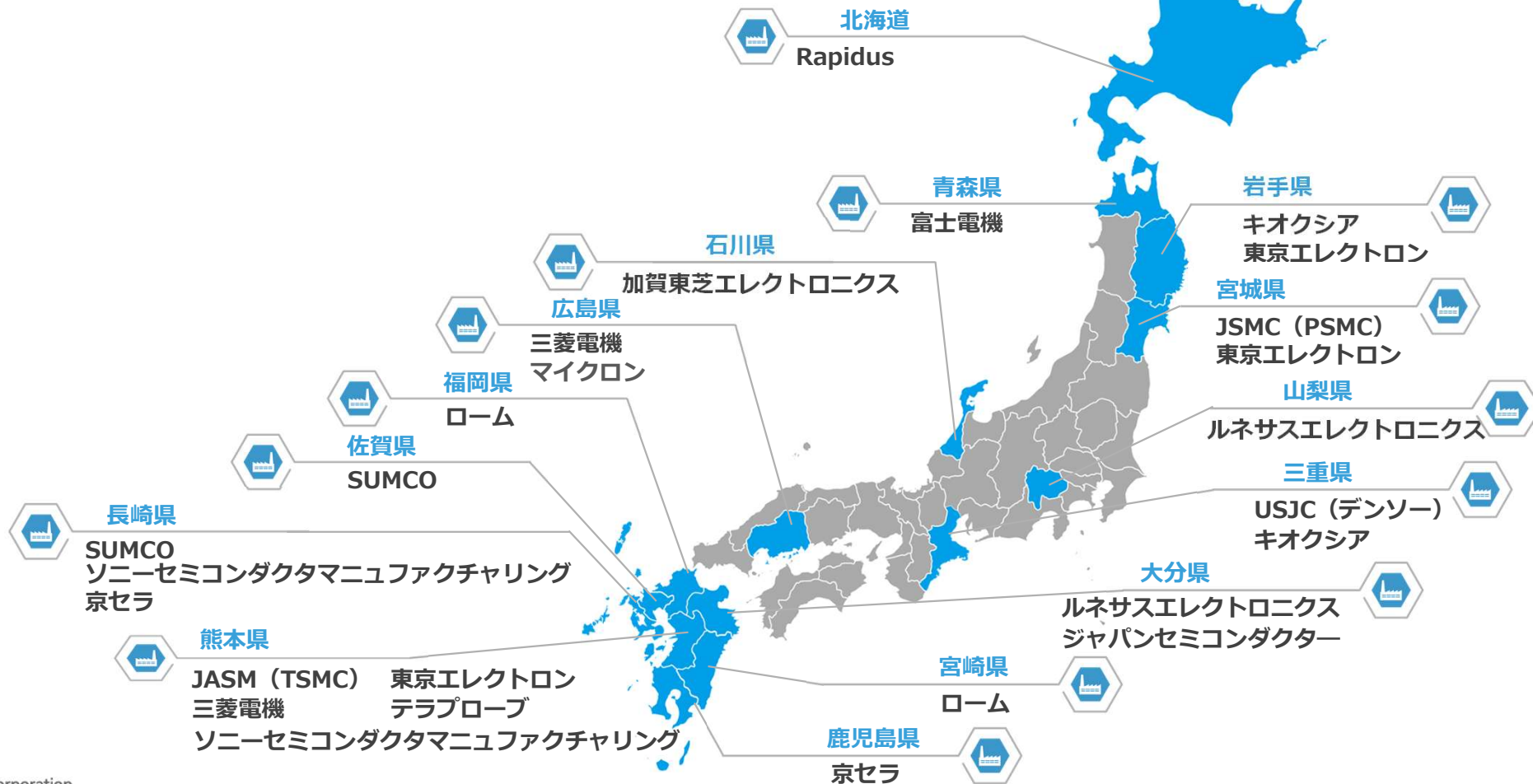
\* 出所：プレジデンス・リサーチ、WSTS、IBSの資料をもとに当社にて作成



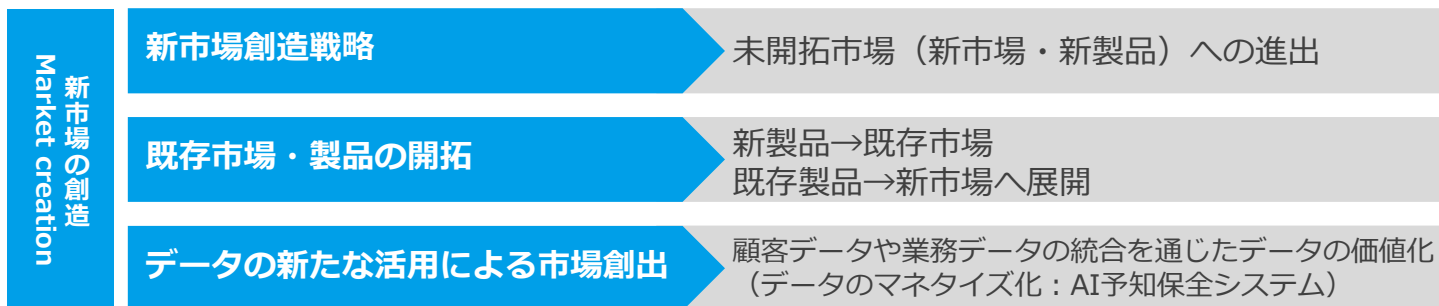
# 増加する国内の半導体関連投資

## メンテナンスサポート分野へ寄与

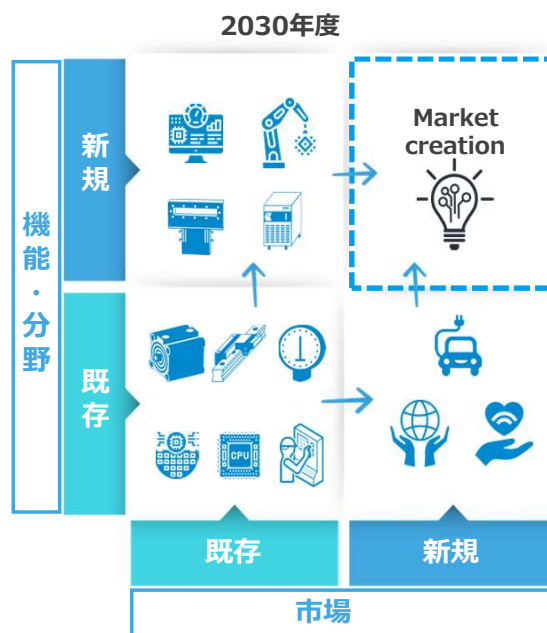
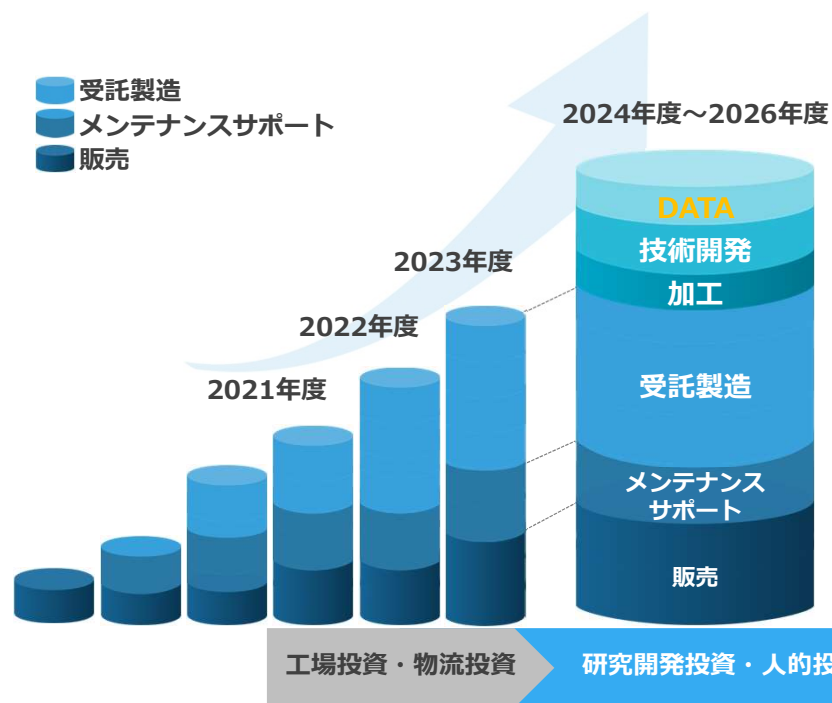
NaigaiTEC



# MIRAI 2026 戦略 Market creation 新市場の創造



目指す姿  
**2030**

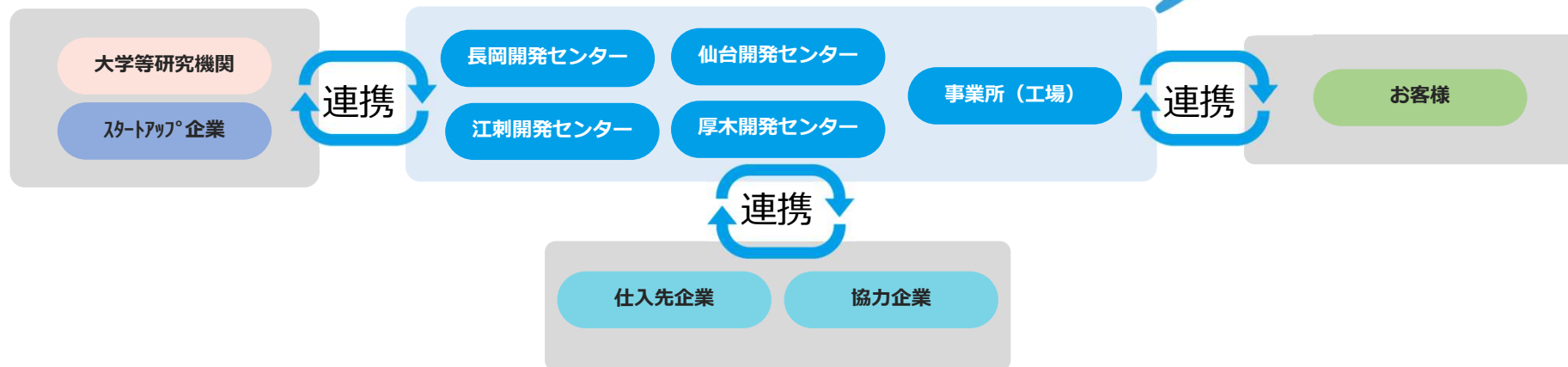
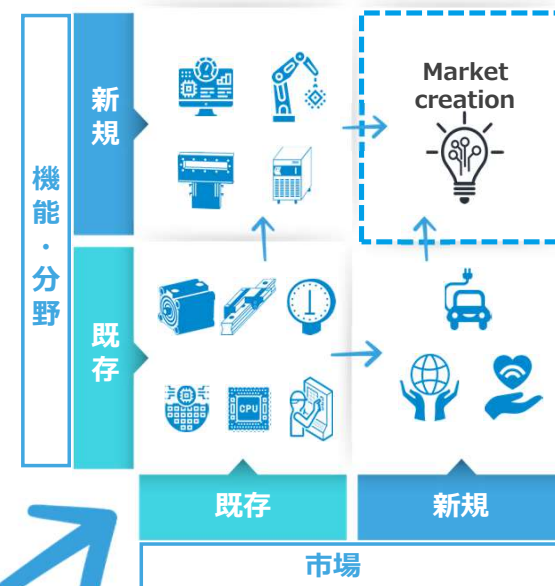


## Market creation

- ・ 予知保全ビジネスから得たデータを収益化
- ・ 半導体エレクトロニクス市場のハブとしての機能化

# MIRAI 2026 戦略 Innovation 技術革新

Innovation 技術革新	新製品への研究開発投資	先進技術の開発や新製品の創出に向けた研究開発への投資
	既存製品の改造技術獲得	既存成熟製品に対する改造設計
	エンジニアの増強	メンテナンスサポート分野の技術者増員と、人材育成システムの強化
	オープンイノベーション	他社やスタートアップとの協業・連携、外部のアイデアを導入
	データの新たな活用	VR/遠隔トレーニングシステムを活用した技術者育成システムの構築



# MIRAI 2026 戦略 Resilience 変化への柔軟な対応

変化への柔軟な対応 Resilience	売上高の拡大	市場の成長率を上回る売上高の増加
	収益力の強化	売上総利益率の改善
	競争優位確立	顧客インハウス・シェアの拡大
	リスク管理体制	外部環境の変化に柔軟・迅速に対応するためのリスク管理体制の構築
	企業風土改革	人材育成風土の醸成
	ガバナンス強化	社外取締役の比率、及び女性取締役の選任
	エンゲージメント向上	働きがい、働きやすさと多様性の確保
	環境対応	CO <sub>2</sub> 削減
	資産の圧縮	ライトアセットと、キャッシュアロケーションの重点的配分
適正なキャッシュポジション	全社的なキャッシュマネジメント	





# MIRAI 2026 戦略 Alliance サプライチェーンの連携

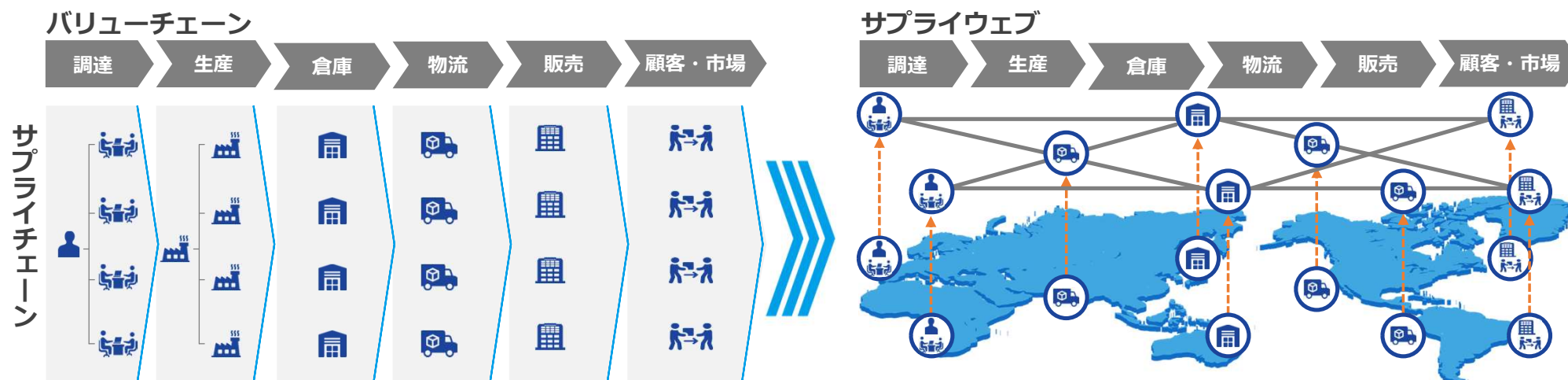
サプライチェーンの連携  
Alliance

**戦略的パートナーシップ** 重要なサプライヤーやパートナーとの戦略的な連携戦略の構築

**サプライチェーン効率化** サプライチェーン全体の効率を向上させ、生産および供給の最適化

**共同研究開発** 他社との協業による新製品・新技術の研究開発

## サプライチェーンから**サプライウェブ**へ進化



\* 図1：サプライチェーン最適化サービスのコンセプト（出典：日立製作所）を  
もとに当社にて作成 <https://it.impress.co.jp/articles/-/18682>

# MIRAI 2026 戦略 **I**ntegration価値の統合

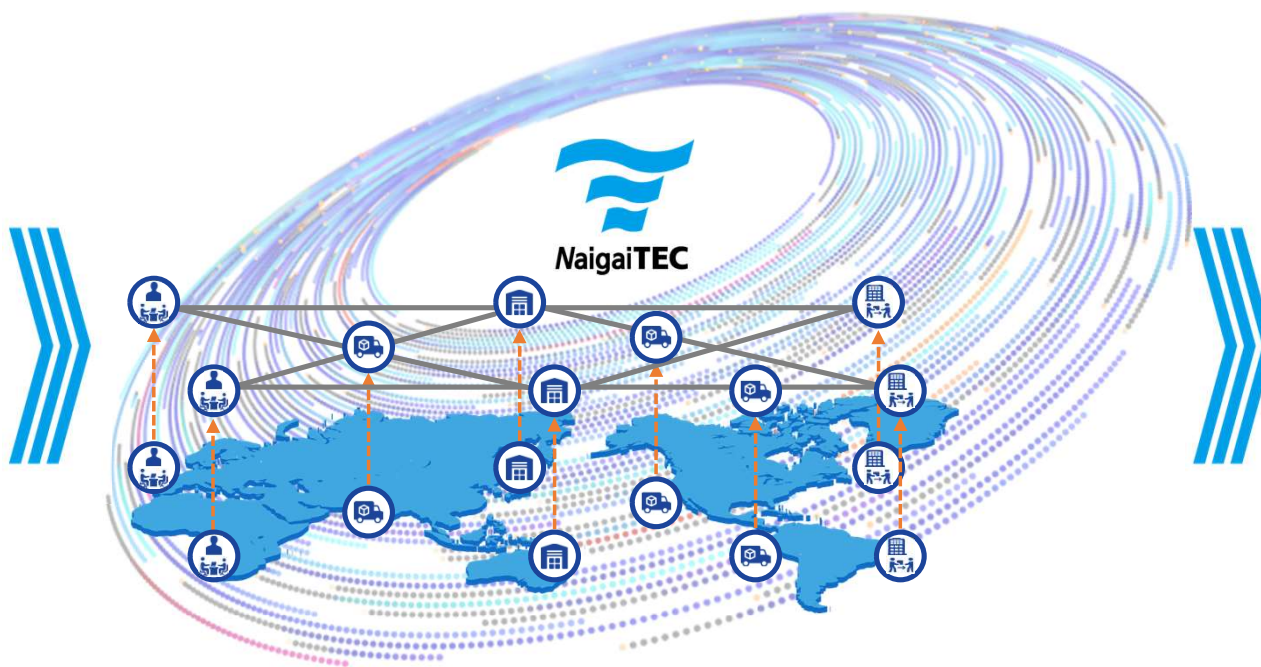
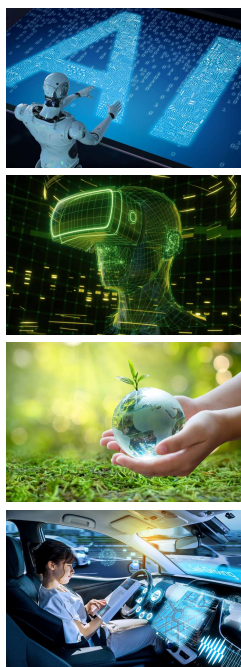
Integration  
価値の統合

顧客への総合的な  
サービスの提供

販売、設計・開発、組立、加工、メンテナサポートまで、  
トータルソリューションサービスを提供

サプライチェーンと  
バリューチェーンの統合

サプライチェーン1,500社と、  
当社のバリューチェーンの統合により、市場に新たな価値を提供



半導体前工程市場

半導体後工程・検査工程市場

電子部品

自動車、二次電池

IT・ソフトウェア

ヘルスケア

\* 図1：サプライチェーン最適化サービスのコンセプト（出典：日立製作所）を  
もとに当社にて作成 <https://it.impress.co.jp/articles/-/18682>

<https://www.naigaitec.co.jp> 証券コード3374

# 前中期経営計画の振り返り

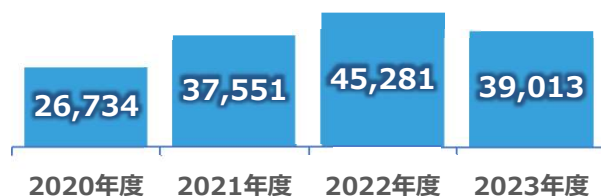
## Point

売上高・利益については、2年目（2022年度）まで計画を上回るペースで順調に推移するも、最終年度は市況悪化の影響を受けて未達に

(百万円)	区分	2020年度実績	2021年度実績	2022年度実績	2023年度実績	前中計目標	対目標比(金額)	対目標比(比率)	達成
売上高	連結	26,734	37,551	45,281	39,013	41,500	▲2,487	▲6.0	▲
営業利益	連結	1,049	2,121	2,349	1,218	2,655	▲1,437	▲54.1	▲
自己資本比率	連結	39.5%	37.6%	35.7%	42.1%	40.9%	—	1.2pt	○
自己資本利益率(ROE)	連結	10.7%	17.5%	16.2%	7.7%	16.3%	—	▲8.6pt	▲
セグメント売上高	販売事業	23,867	33,950	41,388	35,791	37,000	▲1,209	▲3.3	▲
	受託製造事業	5,056	6,483	7,460	5,592	8,000	▲2,408	▲30.1	▲

### 売上高

(単位：百万円)



### 営業利益

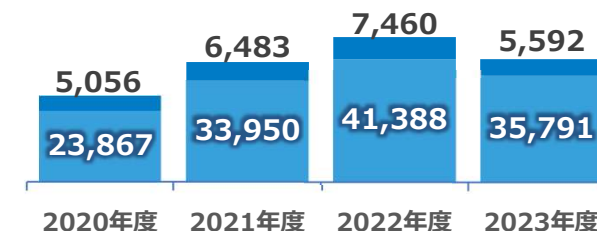
(単位：百万円)



### セグメント別売上高

(単位：百万円)

■ 販売事業 ■ 受託製造事業



# MIRAI 2026 目指す経営指標と定量目標

目指す  
経営指標

売上高

600億円

営業利益

30億円

自己資本比率

43%

ROE

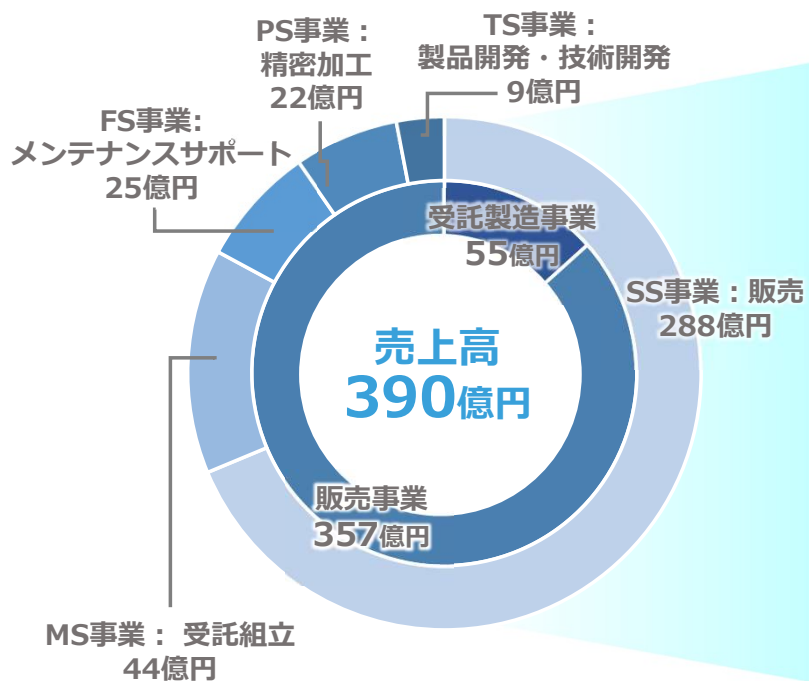
14%

(単位：百万円)	区分	2023年度 実績	2026年度 目標	CAGR (年平均成長率)
売上高	連結	39,013	60,000	15.4%
営業利益	連結	1,218	3,000	35.0%
自己資本比率	連結	42.1%	43.0%	—
自己資本利益率 (ROE)	連結	7.7%	14.0%	—
セグメント売上高	販売事業	35,791	55,000	15.4%
	受託製造事業	5,592	8,500	15.0%

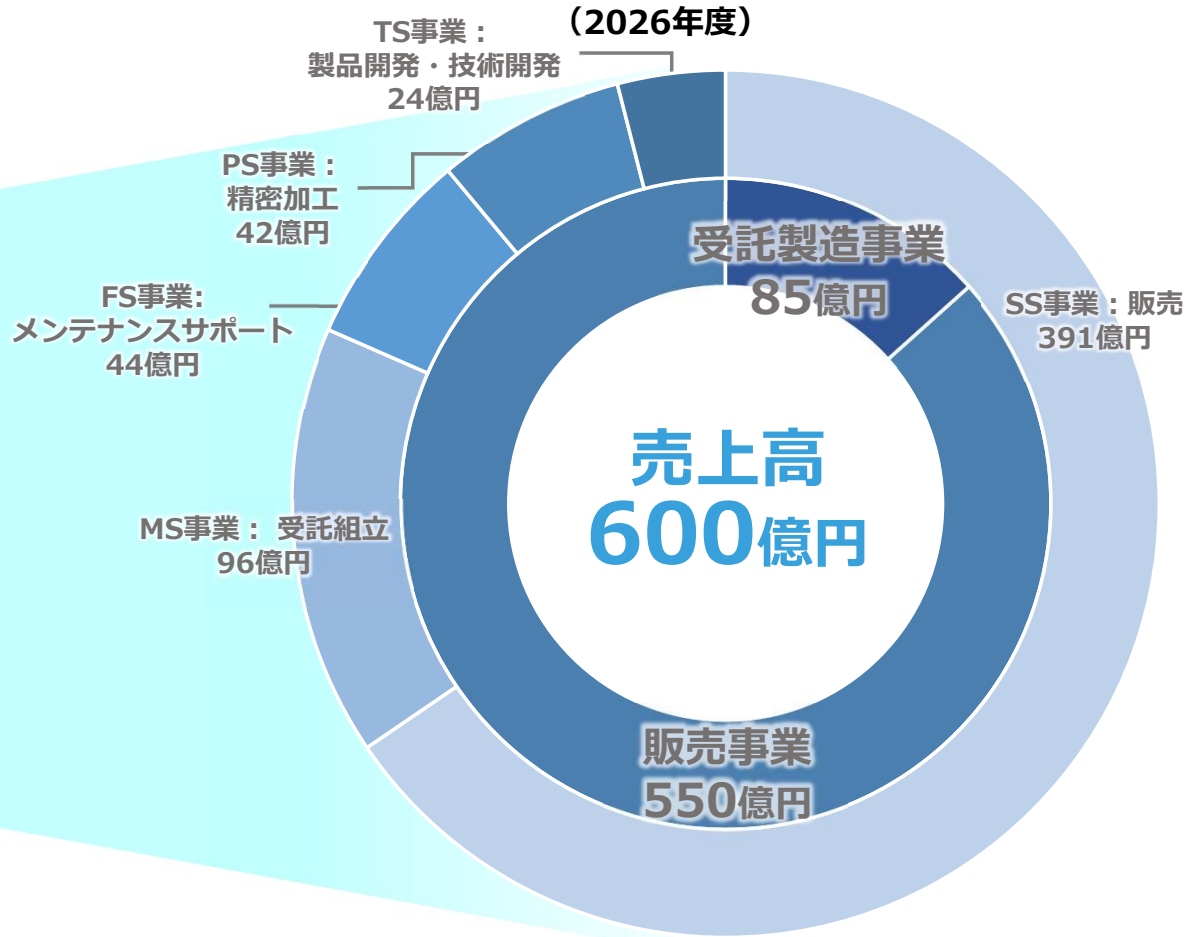


# セグメントと事業ポートフォリオの推移

## セグメント/ポートフォリオ売上高 (2023年度)



## セグメント/ポートフォリオ売上高 (2026年度)



# ESG経営の推進

## 環境対策

CO2排出量の削減目標

2040年までに全社Net Zeroを実現

指標	基準年	目標年	目標水準
Scope1 + 2	2022年度	2030年度	△70%以上
		2040年度	Net Zero
Scope3	2022年度	2040年度	Net Zero

※2030年度までに電力の80%以上を再生可能エネルギーに切替

## 人的資本投資

- ・ 成長戦略に基づいた経験者採用を強化し、多様な人材の登用を継続
- ・ 適材適所の人材配置のほか、計画的な採用・育成を推進、人的資本の最大化
- ・ 人材の多様性促進、女性社員の活躍推進（2026年度 女性管理職比率10%）
- ・ DX活用による人材育成と、育成期間の短縮
- ・ マネジメント力強化、次世代管理職層の育成
- ・ 社員エンゲージメントの向上（働きがい、働きやすさ）

## コーポレートガバナンス強化

- ・ 取締役会の多様性の確保
  - 女性取締役の選任 1名
  - 社外取締役の増員 1名
- ・ 取締役会の実効性の評価に基づく、議論の活性化
- ・ 社外役員とのコミュニケーションの強化

# 株主還元

## 基本方針

連結配当性向 **30%以上**

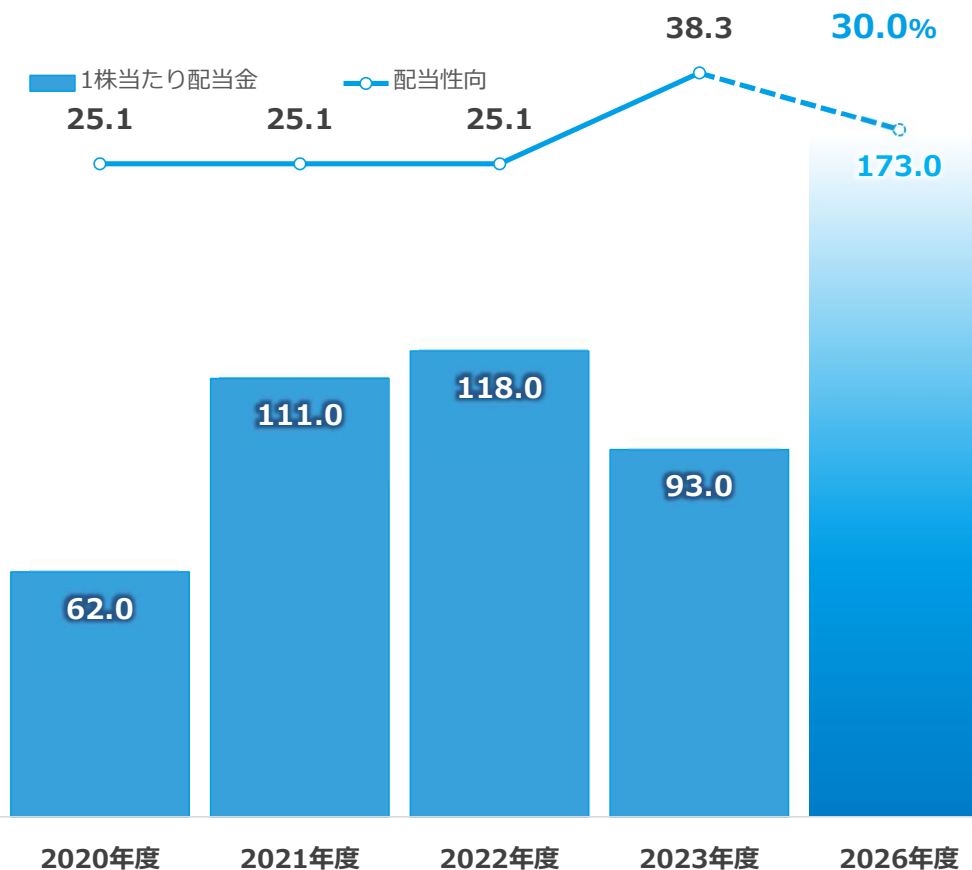
連結株主資本配当率 (DOE) **3%以上**

業績に応じた配当を継続していく

\* 2024年2月13日配当方針の変更

## 株主還元に係る当社の考え方

- 中長期的な視点を持って継続的な企業価値向上により株主様へ還元してまいります
- 今後のさらなる半導体市場の成長を確実にキャッチアップするため、新しい事業領域を含めたM & Aをはじめ、工場の新設等、今後も積極的に投資を行っていきたいと考えております



\* 計画通りの当期純利益が達成できた場合、2026年度（2027年6月配当予定）の1株当たり配当金は、連結配当性向30%の算出が、連結株主資本配当率（DOE）3%を超え、173.0円をなる見込みとなっております。

# NaigaiTEC Corporation

- ・本資料は投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません
- ・本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、その実現・達成を保証、約束するものではなく、また、その情報の正確性、完全性を保証、約束するものではありません
- ・銘柄の選択、投資の最終決定は、ご自身の判断でなさるようお願いいたします

## 内外テック株式会社

<https://www.naigaitec.co.jp>

スタンダード : 3374